

各位

会社名 H P C システムズ株式会社  
代表者名 代表取締役 小野 鉄平  
(コード番号: 6597 東証グロース)  
問合せ先 取締役管理部長 下川 健司  
(TEL. 03-5446-5530)

## 連結業績予想の修正に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、以下のとおり、最近の業績の動向等を踏まえ、2023年11月13日に公表いたしました2024年6月期(2023年7月1日~2024年6月30日)の連結通期業績予想を以下のとおり修正することとしましたので、お知らせいたします。

### 1. 当期の連結業績予想数値の修正(2023年7月1日~2024年6月30日)

	売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属 する当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	7,510	732	705	458	106.70
今回修正予想(B)	6,900	350	336	230	53.57
増減額(B-A)	△610	△382	△369	△228	—
増減率(%)	△8.1	△52.2	△52.3	△49.8	—

(注) 2024年6月期第1四半期より連結決算を開始しておりますので、前期実績(2023年6月期)の数値は記載しておりません。

### 2. 修正の理由

当期におきましては、顧客からの高難度の課題や要望を実現させるために、高度な専門性を有する技術者からなる先端技術開発センターを開設し、高付加価値製品及びサービスの開発を行い売上及び高粗利の確保に努めましたが、粗利率向上には貢献するも、想定していた売上及び高粗利の確保までには至りませんでした。また、期初において懸念されておりましたAIやスーパーコンピュータ向け高性能画像処理半導体GPU(Graphics Processing Unit)の長納期化・入手性悪化リスクに対しては、GPUの適正在庫数量を早期に確保する等の対策を講じ、民間企業や大学等公的機関の投資拡大に対する機会損失を軽減してまいりましたが、民間企業の大規模投資案件に関し、受注獲得のためにハードウェア技術、ネットワーク技術、及びストレージ技術を高度に組み合わせた大規模GPUクラスタの提案を実施する一方、当該大規模GPUクラスタの設置場所において、設置環境を含めた設置場所を自前で供給できる競合との競争の中で、設置場所構築に必要なコストの吸収を伴う価格面の調整が厳しく失注する等、売上高は前回発表を下回る見込みであります。

利益につきましては、上記による売上減の影響に加え、HPC事業における一部の民間企業向け大規模案件において、価格交渉の過程で、円安に伴うコストアップ見込分と顧客企業の設備投資予算額の調整を行いました。調整は厳しく、次期設備増設時の当社受注優位性も見込まれることから、低粗利率での受注となる等、想定通りの利益の獲得が困難となり、売上総利益を圧迫する形となりました。また、販売費及び一般管理費におきましては、人財投資や海外活動を実施しつつ、経費の削減に努めましたが、売上総利益の減少額を補えず前回発表を下回る見込みであります。

なお、期末配当予想につきましては2023年8月14日に公表した内容から変更ありません。

上記予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

以上